

LOGICOM

REPAIR MANUAL/MANUEL DE RÉPARATION

XTREM 60

Tools to be prepared / Outils nécessaires

1/2/3. Screwdriver (T4 hex/Cross/ Flathead type)

4. Tweezers (deal with small components like FPC...)

5/6. Spudger/disassembly tool (use for scraping glue and separating plastic housing parts)

7/8. Crowbar/Plate (slim plastic, to separate the case)

9. Screwdriver box

10. Suction cup (assist to open the screen)

1/2/3. Tournevis (type T4 hexagonal/croix/plat)

4. Pincettes (pour manipuler de petits composants comme les FPC...)

5/6. Spatule / outil de démontage (utilisé pour gratter la colle et séparer les pièces du boîtier en plastique)

7/8. Levier plastique/ Plaque (plastique fin, pour séparer le boîtier)

9. Boîte à tournevis

10. Ventouse (pour faciliter l'ouverture de l'écran)



LOGICOM

Precautions / Précautions

1. Backup the data of the device.

2. Disconnect from power supply and off the device.

3. Wear anti-static cloth/garment, or release static from device.

1. Sauvegarder les données de l'appareil

2. Débrancher l'alimentation électrique et éteindre l'appareil

3. Porter une protection antistatique ou décharger l'électricité statique de l'appareil

STEP 1: Remove the battery cover and the battery

ÉTAPE 1 : Retirer le cache et la batterie.

1. Take out the phone and use a flathead screwdriver to turn each screw counterclockwise until it comes loose. Repeat the same process to unscrew the two battery-cover screws one by one.

2. Use a spudger to gently pry open the battery cover.

3. Gently insert the spudger along the top edge of the battery and pry it upward to remove the battery.

1. Retirez le téléphone et utilisez un tournevis plat pour tourner chaque vis dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se desserre. Répétez la même opération pour dévisser une par une les deux vis du couvercle de la batterie.

2. Utilisez un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la batterie.

3. Insérez délicatement le spudger le long du bord supérieur de la batterie et soulevez-la pour la retirer.



STEP 2: After removing the screws, separate the Case A and Case B. ÉTAPE 2 : Après avoir retiré les vis, séparez le boîtier A et le boîtier B.

1. Use a T4 hex screwdriver to turn counterclockwise and remove the six screws on the left and right strips.

2. Use a T4 hex screwdriver to turn counterclockwise and remove the four guide-corner screws on the top, bottom, left, and right.

3. Use a T4 hex screwdriver to turn counterclockwise and remove the twelve B-case screws.

4. As shown, use the flat end of a spudger to gently pry open the USB plug from the gap between the A and B cases.

5. As shown, insert a thin pry tool into the gap between the top and bottom cases, and slide clockwise along the edge to open the outer shell.

Note: Do not use excessive force when removing the shell or plastic parts to avoid damaging internal components.

1. Utilisez un tournevis hexagonal T4 pour dévisser dans le sens antihoraire les six vis des bandes gauche et droite.

2. Utilisez un tournevis hexagonal T4 pour dévisser dans le sens antihoraire les quatre vis de guidage situées en haut, en bas, à gauche et à droite.

3. Utilisez un tournevis hexagonal T4 pour dévisser dans le sens antihoraire les douze vis du boîtier B.

4. Comme indiqué, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever délicatement le connecteur USB dans l'espace entre les boîtiers A et B.

5. Comme indiqué, insérez un outil fin dans l'espace entre les coques supérieure et inférieure, et faites-le glisser dans le sens des aiguilles d'une montre le long du bord pour ouvrir la coque.

Remarque : lors du démontage de la coque et des pièces en plastique, ne forcez pas pour éviter d'endommager les composants internes.



STEP 3: Remove the speaker, motor, receiver, LED, microphone, and Bluetooth antenna, then take out the screws securing the motherboard and antenna bracket.

ÉTAPE 3 : Retirez le haut-parleur, le moteur, le récepteur, la LED, le microphone et l'antenne Bluetooth, puis retirez les vis fixant la carte mère et le support d'antenne.

1. Pre-tin the five motherboard wire solder points with a temperature-controlled soldering iron, then remove the wires without damaging the pads or wires (lead-free solder, $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$).

2. Unscrew the two antenna bracket screws with a Phillips screwdriver.

3. Pre-tin the microphone wire solder points, then remove the wires without damaging the pads or wires (lead-free solder, $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$).

4. Use tweezers to press and push out the USB plug tail until removed.

5. Unscrew the six motherboard bracket screws
Note: Do not use excessive force when removing wires or plastic parts to avoid damage.

1. Prêtinez les cinq points de soudure des fils sur la carte mère avec un fer à souder à température contrôlée, puis retirez les fils sans endommager les pastilles ni les fils (étain sans plomb, $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$).

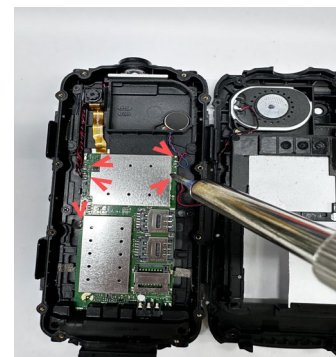
2. Dévissez les deux vis du support d'antenne avec un tournevis cruciforme.

3. Prêtinez les points de soudure du fil du microphone, puis retirez les fils sans endommager les pastilles ni les fils (étain sans plomb, $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$).

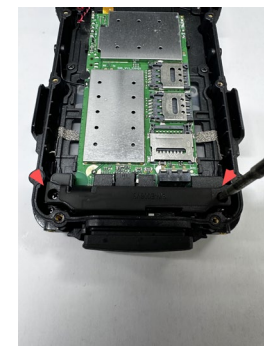
4. Utilisez une pince pour appuyer et pousser la partie arrière du connecteur USB jusqu'à son retrait.

5. Dévissez les six vis du support de la carte mère.

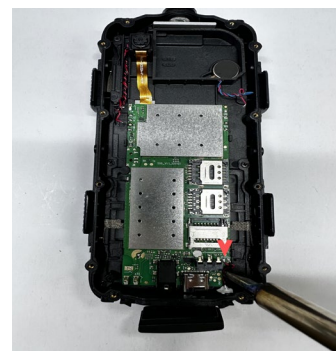
Remarque : Ne forcez pas lors du retrait des fils ou des pièces en plastique pour éviter d'endommager les composants.



1



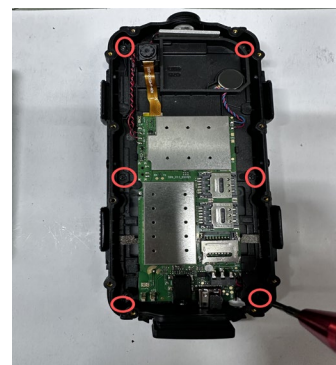
2



3



4



5

STEP 4: Separate the mainboard bracket from the housing/Remove the LED, motor, camera, and screen/Separate the mainboard from the mainboard bracket.

ÉTAPE 4 : Séparer le support de la carte mère du boîtier/Retirer la LED, le moteur, la caméra et l'écran/Séparer la carte mère de son support.

1. Gently unplug the receiver, LED, and motor cables. Insert a pry tool into the gap between the mainboard bracket and the housing, slide it clockwise along the edge to release the bracket, separate it from the housing, and remove the LED.
2. Use the pointed and flat ends of the scraping tool to gently pry up the motor and camera from the bottom, then remove the speaker cavity foam, the motor, and the camera.
3. Use tweezers at this position to lift and gently remove the display IC support foam, the camera pad insulation tape, and the conductive fabric on both sides of the mainboard, moving from right to left and top to bottom. Be careful not to damage the display or the camera FPC cables.
4. Use a temperature-controlled soldering iron to pre-tin the display and camera FPC pads on the mainboard. Then, starting from the tinned area, use the soldering iron to remove the FPC. Be careful not to damage the pads or the FPC cables (lead-free solder, $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$).
5. Push the mainboard upward from the bottom with your finger, allowing the six clips to release one by one from right to left and top to bottom, until the mainboard comes free from the clips.

Note: Do not use excessive force when removing parts to avoid damaging the components.

1. Débranchez délicatement les câbles du récepteur, de la LED et du moteur. Insérez un outil de levier dans l'espace entre le support de la carte mère et le boîtier, faites-le glisser dans le sens horaire le long du bord pour ouvrir le support, le séparer du boîtier et retirer la LED.

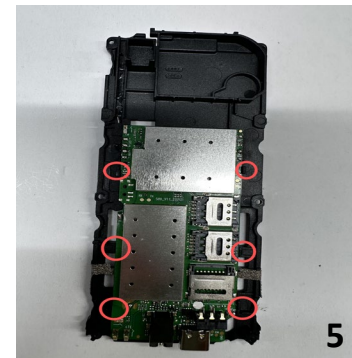
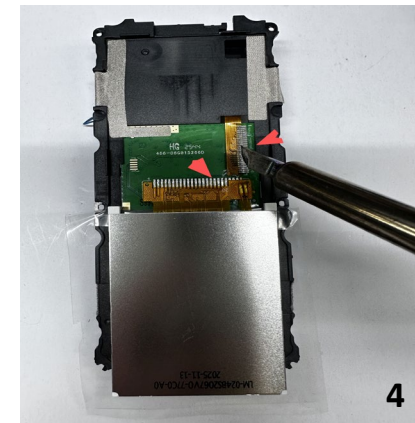
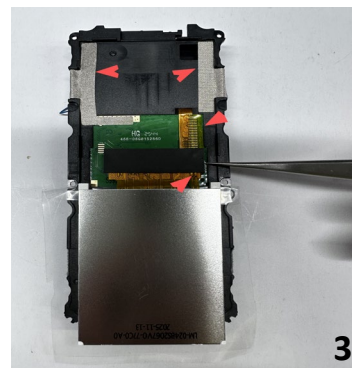
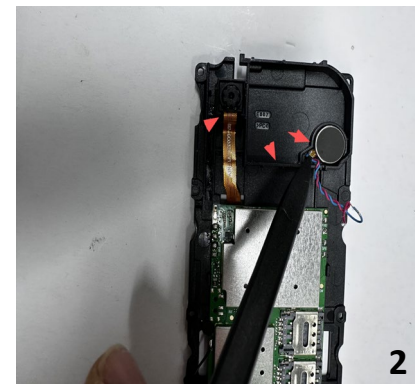
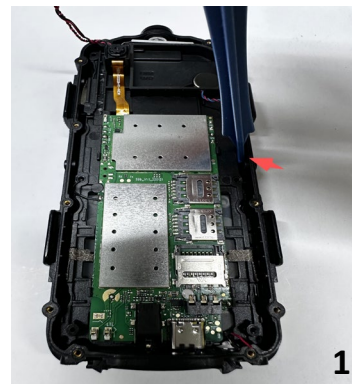
2. Utilisez les extrémités pointue et plate de l'outil pour soulever délicatement le moteur et la caméra par le bas, puis retirez la mousse de la cavité du haut-parleur, le moteur et la caméra.

3. À cet endroit, utilisez une pince pour soulever puis retirer délicatement la mousse de support de l'IC d'affichage, l'isolant du pad de la caméra et les tissus conducteurs des côtés droit et gauche de la carte mère, de droite à gauche et de haut en bas. Faites attention à ne pas endommager les nappes FPC de l'écran et de la caméra.

4. Utilisez un fer à souder à température contrôlée pour pré-étamer les pastilles des FPC de l'écran et de la caméra sur la carte mère. Ensuite, à partir de la zone étamée, retirez le FPC avec le fer à souder. Veillez à ne pas endommager les pastilles ni les nappes FPC (soudure sans plomb, $370^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$).

5. Poussez la carte mère vers le haut depuis le bas avec votre doigt afin que les six clips se libèrent un par un, de droite à gauche et de haut en bas, jusqu'à ce que la carte mère se détache complètement des clips.

Remarque : N'exercez pas de force excessive lors du démontage afin d'éviter d'endommager les composants.



STEP 5: Remove the faulty DOME sheet from the mainboard.

ÉTAPE 5 : Retirez la pastille DOME défectueuse de la carte mère.

1. Use your finger to slowly remove the faulty DOME sheet from left to right and top to bottom.

Note: Avoid using excessive force when disassembling parts to prevent component damage.

1. Retirez lentement la pastille DOME défectueuse avec le doigt, de gauche à droite et de haut en bas.

Remarque : Ne pas exercer de force excessive lors du démontage pour éviter d'endommager les composants.



1



2

STEP 6: Remove the glued components: receiver, buttons, microphone, speaker, side strip pins, rear case waterproof ring, FM antenna, and device label.

ÉTAPE 6 : Retirez les composants collés : récepteur, boutons, microphone, haut-parleur, goupilles de la bande latérale, joint étanche du boîtier arrière, antenne FM et étiquette de l'appareil.

1. Insert the pointed end of a scraping tool into the glue groove gaps of the receiver, buttons, and microphone housing. Slide it clockwise along the edges to pry them open and separate from the housing, then remove the receiver, buttons, microphone, and units.

2. Insert the pointed end of a scraping tool into the glue groove gap of the speaker housing. Slide it clockwise along the edges to pry open the speaker and separate it from the housing, then remove the speaker unit.

3. Use the flat end of tweezers to press the tails of the 4 side strip pins from the inside out until they pop out, then use the pointed end of tweezers to remove the pins.

4. Insert the pointed end of tweezers at the bottom-right corner to gently lift the rear case waterproof ring. Peel off the adhesive at the gold finger area from the inside, then slowly remove the FM antenna from the outside. Peel off the adhesive at the device label area from the inside, then slowly remove the label from the outside.

Note: Do not use excessive force when disassembling parts to avoid damaging components.

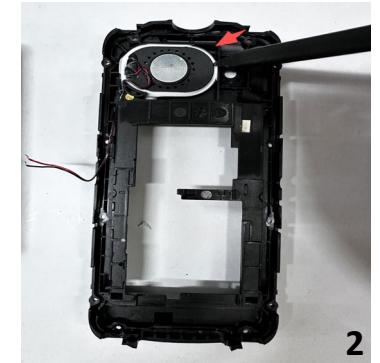
1. Insérez l'extrémité pointue d'un outil de grattage dans les interstices des rainures de colle du boîtier du récepteur, des boutons et du microphone. Faites-le glisser dans le sens horaire le long des bords pour les soulever et les séparer du boîtier, puis retirez le récepteur, les boutons, le microphone et les unités.

2. Insérez l'extrémité pointue d'un outil de grattage dans l'interstice de la rainure de colle du boîtier du haut-parleur. Faites-le glisser dans le sens horaire le long des bords pour soulever le haut-parleur et le séparer du boîtier, puis retirez l'unité du haut-parleur.

3. Utilisez l'extrémité plate de la pince pour presser les queues des 4 goupilles de la bande latérale de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles sortent, puis utilisez l'extrémité pointue de la pince pour retirer les goupilles.

4. Insérez l'extrémité pointue de la pince dans le coin inférieur droit pour soulever délicatement le joint étanche du boîtier arrière. Retirez l'adhésif de la zone des contacts dorés depuis l'intérieur, puis retirez lentement l'antenne FM depuis l'extérieur. Retirez l'adhésif de la zone de l'étiquette de l'appareil depuis l'intérieur, puis retirez lentement l'étiquette depuis l'extérieur.

Remarque : Ne pas exercer de force excessive lors du démontage afin d'éviter d'endommager les composants.



STEP 7: Remove residual adhesive from the front and rear housings, as well as from the receiver, buttons, microphone, and speaker areas.

ÉTAPE 7 : Retirez les résidus de colle des coques avant et arrière, ainsi que des zones du récepteur, des boutons, du microphone et du haut-parleur.

1. Insert the pointed end of a scraping tool into the glue grooves of the receiver, buttons, and microphone housing. Slide clockwise along the edges to clean out the residual adhesive.

2. Insert the pointed end of a scraping tool into the glue groove of the speaker housing. Slide clockwise along the edges to clean out the residual adhesive.

Note: Do not use excessive force when cleaning residual adhesive to avoid damaging components.

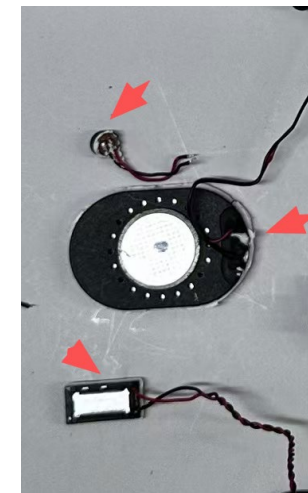
1. Insérez l'extrémité pointue d'un outil de grattage dans les rainures de colle du boîtier du récepteur, des boutons et du microphone. Faites glisser dans le sens horaire le long des bords pour nettoyer les résidus de colle.

2. Insérez l'extrémité pointue d'un outil de grattage dans la rainure de colle du boîtier du haut-parleur. Faites glisser dans le sens horaire le long des bords pour nettoyer les résidus de colle.

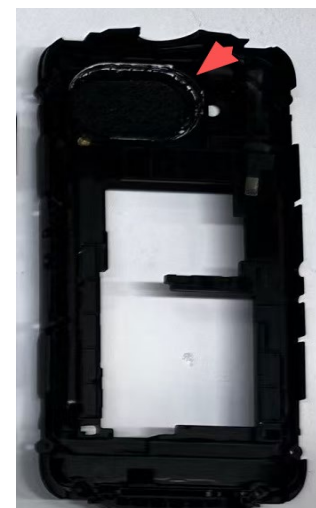
Remarque : Ne pas exercer de force excessive lors du nettoyage des résidus de colle pour éviter d'endommager les composants.



1



3



2

Components List / Liste des composants



LOGICOM

Item Component name (EN)

- 1 Back cover
- 2 PCBA Bracket
- 3 Back housing waterproof part
- 4 Front housing
- 5 Back housing
- 6 USB waterproof plug
- 7 LTE antenna bracket
- 8 DOME
- 9 Rear Camera
- 10 Motor
- 11 Mic
- 12 Speaker
- 13 Receiver
- 14 Buttons
- 15 Metal side bar
- 16 Corner cover
- 17 PCBA conductive cloth
- 18 Speaker cavity foam
- 19 LCD IC support foam
- 20 PCBA
- 21 LCD
- 22 LED
- 23 Bluetooth line
- 24 Camera lens
- 25 LED lens
- 26 Main lens
- 27 Side strip pin conductive foam
- 28 Chamfered screw
- 29 Side pin
- 30 Antenna / PCBA bracket screw
- 31 Metal side bar screw
- 32 Back cover screw
- 33 LCD pressing foam
- 34 Camera pad insulation adhesive

Nom du composant (FR)

- Coque arrière
- Support PCBA
- Pièce étanche du boîtier arrière
- Boîtier avant
- Boîtier arrière
- Bouchon étanche USB
- Support d'antenne LTE
- Dôme
- Caméra arrière
- Moteur
- Micro
- Haut-parleur
- Écouteur
- Boutons
- Barre latérale métallique
- Cache d'angle
- Tissu conducteur PCBA
- Mousse de la cavité du haut-parleur
- Mousse de support IC LCD
- PCBA
- LCD
- LED
- Câble Bluetooth
- Lentille de la caméra
- Lentille LED
- Lentille principale
- Mousse conductrice pour pin de bande latérale
- Vis chanfreinée
- Goupille latérale
- Vis du support d'antenne / PCBA
- Vis de la barre latérale métallique
- Vis du couvercle arrière
- Mousse de maintien LCD
- Colle isolante pour pastilles de caméra